

# 带双区Pid控制与集成水冷的自动大尺寸实验室热压压机

货号: XP64



## 简介

KINTEK自动大尺寸实验室热压压机，提供5吨压力、330×330mm加热板、双区PID加热与水冷功能，是聚合物薄膜制备、层压、复合材料固化的理想设备，通过CE认证，立即咨询报价。

[了解更多](#)

应用场景	说明	核心优势
聚合物薄膜与板材成型	用于热压热塑性板材、聚合物薄膜或橡胶混合料，制备光滑均匀的面板。大尺寸热板与可控压力可防止翘曲，确保微米级基材厚度一致。	可为研发样品和小批量生产达到工业级平面度与可重复厚度。
层压板粘合（层压工艺）	非常适合在精确温度和压力下粘合多层印刷电路板、柔性印刷电路或复合织物。均匀温度分布可避免敏感电子层出现分层和气泡。	可制备无空隙、粘合紧密的组件，实现优异的层间附着力。
复合材料固化	非常适合固化低压复合预浸料，如碳纤维或玻璃纤维环氧树脂，这类材料需要稳定温度和均匀压缩。水冷可帮助在压力下快速降温，提升力学性能。	可生产高强度、尺寸稳定的复合板材，适用于结构测试。
大尺寸垫片与密封件硫化	用于在可控温度下成型固化大尺寸橡胶或弹性体密封件和垫片。温和压力可保证材料密度，不会挤出多余材料。	确保固化均匀、尺寸公差精确，实现可靠密封性能。
电池组件制备	应用于压制锂离子和其他类型电池的电极片、隔膜片或固态电解质 pellet。双区加热与低压非常适合敏感电池材料，可实现压实时不产生开裂。	可实现均匀的组件密度和界面质量，对电池循环寿命和安全性至关重要。
柔性电子层压	用于柔性显示器、有机光伏器件或可穿戴传感器的封装与层压。精确控温与均匀压力可保护脆弱功能层。	保证先进电子器件获得高良品率、无缺陷层压效果。

参数	规格	说明与安全提示
型号	XP64	
操作方式	全自动液压控制	
最大压力	0-5吨 (0-50千牛)	压力可精密调节
工作温度	0-300°C	
加热控制	双热板独立加热控制	独立双区管控
温度控制	PID可编程控制器	支持多段程序设置
加热功率	4500W	
热板尺寸	330×330mm	大尺寸加热板
热板最大面压	0-4.5巴 (0-0.45MPa)	适用于中低压层压与固化
活塞行程	60mm	有效活塞位移
开口高度	可调节/可定制配置	请与技术销售代表确认
冷却方式	循环水冷	内置流道；可选购循环冷却机

参数	规格	说明与安全提示
电源	交流220V, 50Hz	电流约20.5A, 需要32A单相工业断路器

认证 CE